

证券代码：688727

证券简称：恒坤新材

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-01

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称	兴业证券、泰康资产、中邮证券、华福证券、东方证券、兴全基金、华泰证券、易方达基金、中国银河证券、厦门益亨投资、黄石国资基金、向三创股份公司、冯源资本、兴业基金、华能贵诚信托、厦门中略投资、广发证券、国投瑞银、长江证券、鲁资创投、中银国际证券、申万菱信基金、申万宏源证券、国鑫创投基金。
时间	2026 年 1 月 7 日 10:30-12:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 易荣坤先生 董事兼副总经理 王廷通先生 董事会秘书 陈颖峥女士 财务总监 陈志明先生
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，是境内少数具备 12 英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一，主要从事光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售。报告期内，公司已量产供货产品包括 SOC（碳膜涂层）、ARC（抗反射涂层）、i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶等光刻材料以及 TEOS 等前驱体材料，ArF 光刻胶已通过验证并小规模销售。公司产品主要应用于先进 NAND、DRAM 存储芯片与 90nm 技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节，系集成电路晶圆制造不可或缺的关键材料。</p>

二、问答环节

Q: 介绍公司发展历程及产品国产化进程?

A: 1. 初创期（2004-2014 年）：初期经营传统业务，受市场竞争影响促进公司战略转型；

2. 转型期（2015-2019 年）：战略转型初见成效，2017 年公司引进光刻材料与前驱体材料陆续通过客户验证并实现销售，销售先行提升研发信心；

3. 突破期（2020 年至今）：2020 年至今自研产品全面突破，同年漳州光刻材料工厂投产；2021 年大连前驱体材料工厂投产，合肥工厂已具备部分投产条件；2023 年承接多项国家专项，部分已结案，部分仍在推进中；2025 年及未来将通过募投项目实施，实现 KrF/ArF 光刻胶及其他光刻材料年产 500 吨的生产能力。未来，公司要采用“自主研发+合作研发+技术引进”模式来推进上游原材料国产化。

Q: 中日关系变化后，客户推动国产化的意愿是否提升？

A: 客户一直在持续推进国产化，中日关系变化后意愿增强。因光刻胶替代难度大、风险高，目前国产化率仍较低。

Q: 客户群体的类型及原因？

A: 公司客户群体涵盖境内多家领先 12 英寸集成电路晶圆厂，以存储客户为主，其余为逻辑芯片客户。逻辑芯片客户导入较慢，取决于重点客户的需求，随着时间推移，客户产能扩大，后续将有序增长。

Q: 公司的关键原材料树脂的采购情况以及树脂国产化难度大的原因是什么？

A: 国内树脂市场国产化率已达双位数，完全国产化仍需时间。公司一方面通过自身研发投入，目标实现国产化应用，另一方面目前通过与八亿时空合作，推进供应链协同。其他供应商仍在测试阶段。树脂上游原材料（如单体、PAG 等）国产化也有难度，需要时间积累，未来将逐步推进完全国产化。

Q: 光刻材料产线的规划？

A: 公司战略规划共有两个光刻材料工厂——漳州工厂和合肥工厂。目前光刻材料产能集中在漳州工厂，已不能满足未来客户的需求。合肥工厂占地 100 亩，已完成部分规划建设，将逐步释放产能。

Q: 2025 年上半年公司引进业务大幅下滑的原因？

A: 出于集中全力推进国产化战略考量，自 2025 年起公司终止部分引进光刻材

料产品的合作，并通过自主研发产品的迅速推进扩大市场份额，抵消了引进业务大幅下滑对公司业绩造成的影响。

Q：光刻材料国产替代的模式？

A：光刻材料为高度客制化产品，根据客户的需求我们提供解决方案。公司产品已经超过 100 多款，包括在研产品、已通过验证产品及已量供的产品。

Q：前驱体材料的规划？

A：公司目前生产的前驱体产品为硅基前驱体，已稳定批量供货。金属基前驱体处于研发和测试阶段，尚未形成销售，募投项目已规划金属基前驱体的产能。因前驱体为相对标准化的产品，未来具备出海的可能性。

Q：研发团队的结构以及研发投入规划？

A：通过引进人才和内部培养相结合，组成多元化的研发实力。我们将继续加大研发投入，持续推进产品迭代，重点突破核心技术与原材料瓶颈。

Q：客户替换光刻胶产品的难度？

A：光刻胶的替换对客户产品品质良率的影响很大，将影响整个产品生态系统，客户需要愿意投入时间测试，验证材料与工艺的适配性，直至稳定供货，时间可能长达 3-4 年。

Q：ArF 放量需要多长时间？若断供，公司能否快速替代？

A：ArF 放量取决于客户的需求以及我们产品的适配能力。公司 2025 年上半年已经有几十万的 ArF 收入，预计 2026 年将持续增长。因为产品品类众多，公司无法全部覆盖，部分产品可替代，完全替代仍需时间。

Q：客户是否有压价需求？公司如何应对？

A：降本是所有企业的需求。公司将通过优化供应链、提升管理能力、推进原材料国产化来对冲成本压力。

Q：未来 2-3 年半导体材料行业是否会比过去更好？

A：我们看好行业前景，主要原因有三：AI 需求暴增推动客户端产能投入；国内晶圆厂持续扩产；国产化要求强烈。这些对公司发展均有利。

Q：公司是否会布局抛光液等其他材料？

A：国内已有同行布局的领域，我们短期内不会进入。将集中精力推进国产化缺口较大的产品，避免重复投入。

	<p>Q: 公司在 2025 年在手订单相比 2024 年减少，如何解决？</p> <p>A: 缺口系因公司舍弃部分引进业务。但我们一直在推进自研产品，后续将通过自研产品来增加订单。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单	无
日期	2026 年 1 月 8 日